

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2026-015

## 苏州东山精密制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	东山精密	股票代码	002384
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称 (如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冒小燕	周浩	
办公地址	苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼	苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼	
传真	0512-80190029	0512-80190029	
电话	0512-80190019	0512-80190019	
电子信箱	maoxy@dsbj.com	hao.zhou@dsbj.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于智能制造领域、具备全球化视野与布局的创新驱动型公司，以创造更互联互通的新世界为使命，以成为全球领先的智能互连方案解决商为愿景，致力于为全球顶尖科技公司提供先进产品与解决方案，最终实现人、设备以及基础设施之间的互联互通。公司主要从事电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组的全球设计、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车、数据中心、通信设备、工业控制设备等领域。公司通过全方位、一

体化的综合服务，持续深化客户合作粘性，与全球头部企业建立长期稳定的战略合作关系。

(一) 公司主要产品及其用途情况如下：

产品	类型	产品特性介绍	主要应用
	软板	<p>软板是一种 PCB，以聚醯亚胺或聚酯薄膜等柔性材料为基材，通过铜箔层实现电气互联。其独特的适应性使其可反复弯曲、折叠和扭转，且不会影响电气性能的稳定。这种柔性特性让软板能无缝安装在狭窄或不规则空间中，既减轻重量，又提供更高的设计自由度。这些特点使软板成为紧凑型设备以及对便携性和耐用性有要求的应用场景的理想解决方案。</p> <p>我们的软板产品系列包括单层软板、多层软板以及 FPCA，其可将电阻、电容、电感及各类功能芯片直接集成在电路上。这些产品经过专门设计，能够满足各行业终端产品的性能需求。我们的软板厚度最薄可达 0.05 毫米，针对超薄、轻量化设计进行了优化，可实现兼具空间效率与性能的紧凑型解决方案。为确保耐用性和可靠性，我们采用先进材料，使其能承受高温，并在严苛环境下保持信号完整性。</p> <p>软板广泛应用于边缘 AI 设备、消费电子及汽车电子领域。在边缘 AI 设备中，我们的软板对打造更轻薄、更先进的产品愈发重要，能在日益小型化的形态下支持高性能功能。全球多家领先品牌的 AI 智能手机、可穿戴设备及其他智能设备均采用了我们的软板。在汽车领域，我们的软板可在空间受限环境中实现复杂布线，为汽车电池管理系统、车载信息娱乐系统等关键系统提供支持。随着各行业不断发展，我们的软板始终处于技术前沿，助力开发更智能、更紧凑、更高效的下一代 AI 设备。</p>	智能手机、电动汽车 BMS 系统等
	硬板	<p>硬板是采用不可弯曲或扭曲的刚性基板制成的 PCB。我们的硬板产品涵盖单层 PCB、多层 PCB 及 HDI，以满足客户在 AI 计算及消费电子等不同行业的需求。</p> <p>单层及双层 PCB 结构的设计简易，以刚性基板分隔单层或双层铜箔线路。此解决方案具成本效益，广泛适配中等复杂度的电子系统。多层 PCB 包含由绝缘材料分隔的多层导电铜，可提供更高的元件密度和电气性能。HDI 通过先进的通孔结构（如盲孔和埋孔）实现更高的布线密度和元件小型化，从而进一步提升整合度。</p> <p>具体而言，在空间受限的应用中，高多层 PCB 和高阶 HDI 可实现紧凑布局、更佳信号性能和更高可靠性。因此，其特别适用于高频及高速数据传输至关重要的 AI 算力基础设施。我们的 ELIC 技术是 HDI 领域的领先技术，它能够实现任意层之间的互连，从而在极致紧凑的设计中实现超高密度布线。我们的多层 PCB 和 HDI 采用超低损耗 M8/9 级材料，实现高达 224Gbps 的传输速率，满足 GPU、AI 加速卡、AI 服务器及数据中心交换机的严苛要求。</p> <p>公司凭借高多层 PCB 及 HDI 领域的深厚技术储备，保障产品在严苛环境下实现高速低损耗互联。针对高功率应用的散热需求，通过嵌入式铜块、埋置铜柱与激光填铜等技术，有效提升散热增强型 PCB 的热扩散效率与可靠性。</p>	AI 服务器、5G 基站、智能汽车、AR&VR 设备、可穿戴设备、机器人等
	软硬结合板	<p>软硬结合板由多层刚性线路层及柔性线路板组成，通过电镀通孔连接，使其能良好适配紧凑及复杂的电子产品结构设计。它结合了硬板的耐用性与软板的适应性，兼顾机械强度和设计灵活性。柔性部分允许移动或折叠，而刚性部分为安装部件提供结构支撑和空间。</p> <p>这种独特的组合减少了对连接器和电缆的需求，简化了组装，并通过消除潜在的故障点来提高可靠性。我们的软硬结合板产品采用高性能材料，以确保在严苛环境下的热稳定性和可靠性。因此，此产品特别适用于医疗器械和汽车系统等行业，考虑到这些行业的设备既需要高性能，又需要能够适应狭小的空间。</p>	AI 服务器、数据中心交换机、智能汽车、智能手机及平板电脑、AR&VR 设备、CT 扫描仪、工业设备、机器人等
光模块	光芯片	<p>依托子公司索尔思光电，公司布局以高速 EML 芯片为核心的光芯片产品体系，速率覆盖 2.5G 至 200G 全系列矩阵，采用 IDM 全流程自研与规模化量产模式，产品具备高带宽、低功耗、低传输损耗、高消光比、量产良率优异及宽温域高可靠性等突出优势。公司主力推出 100G/200G PAM4 EML 高端芯片，关键性能指标与量产能力达到国际一流水平，可充分适配 800G、1.6T 及更高速率光模块应用；同时前瞻布局 400G EML、高功率 CW 光源等技术，能够满足 AI 数据中心、超算高速互联等高端场景的严苛应用需求。</p>	光模块

产品	类型	产品特性介绍	主要应用
	数据中心光模块	<p>在 AI 计算与应用快速发展的推动下，我们的数据中心光模块专为满足 AI 基础设施的需求而设计。我们专注于模组 QSFP-DD、QSFP112 及 OSFP 封装的 400G 光模块，以及基于 DSP、LPO 与 LRO 架构的 OSFP 及 QSFP-DD 800G 光模块。我们的 1.6T 光模块提供 EML、硅光及 InP PIC 等多种技术选项，采用 OSFP 等紧凑封装实现超高速、低延迟连接。我们的自研 100G PAM4 EML 芯片在 400G 及 800G 光模块中累计使用超千万颗，200G PAM4 EML 芯片已进入量产阶段，为 1.6T 光模块提供支撑。</p> <p>同时，我们正在研发的 400G PAM4 EML 芯片将赋能 3.2T 光模块。此外，我们正推进共封装光学技术，该技术把光引擎与交换芯片直接集成到同一封装内，能显著缩短信号路径并降低延迟，使其非常适合用于 AI 训练与推理。</p> <p>我们的数据中心产品采用低损耗光学材料、稳定的信号完整性设计及自适应电源管理技术，实现稳定传输与更高能效。该等创新不仅降低了功耗，还提升了成本优势与耐用性，使我们的解决方案能够满足 AI 数据中心对速率与带宽的严苛要求。</p>	数据中心等
	电信光模块	<p>我们的电信产品主要包括用于光传输、无线传输及宽带的产品。</p> <p>我们的光传输产品为满足城域、接入及长途网络对高速数据传输日益增长的需求而设计，兼具高可靠性与长距离传输性能。产品支持 SFP、SFP+、SFP28 及 QSFP-DD 等多种尺寸规格与数据速率，传输能力覆盖 1G 至 800Gb/s 范围。</p> <p>我们的无线传输模组基于无线网络物理层工作，实现精确的电—光与光—电信号转换，支撑 BBU、AAU 与 DU 间的高速数据交互，为前传、中传与回传提供稳定可靠的连接能力。该等模组全面兼容 5G 与 5.5G 网络部署。</p> <p>我们的宽带产品基于 PON 架构，这是一个点对多点的光纤系统，通过无源分光器连接 OLT 与 ONU/ONT，无需现场供电设备。产品覆盖 10G PON 与 25G/50G PON，符合 F5G 及 F5G-A 标准，广泛部署于 FTTH、企业宽带及园区网络，为终端用户提供高速数据服务。该等采用自研 50G 激光芯片的解决方案已在商用 50G-PON 项目中部署，从而赋能高速宽带与 AI 数据中心。</p>	数据中心、企业专线业务、核心网与基站等
精密组件	汽车零部件	<p>我们提供各类汽车结构件与功能模组产品，适配整车不断升级的功能需求，核心产品涵盖电池壳体、水冷板、EV 电机壳体等，该类部件对整车动力性能、运行安全及能源利用效率提升具有关键作用。</p> <p><b>电池壳</b> 电池壳体为一体化结构部件，采用轻量化高强度铝合金材质，用于封装电池模组及内部核心元器件，可为电池系统提供全方位防护，有效抵御外部冲击。壳体集成一体化热管理流道，可显著提升散热效率；同时电池下壳体参与整车底盘集成，有助于降低整车重心，提升行驶稳定性。公司采用 8200 吨一体化冲压成型、高精度激光焊接等先进工艺，并配套自动化 CCD 视觉检测系统，保障产品尺寸精度与品质一致性。依托上述制造技术，产品具备优异的安全性与可靠性，适配新能源整车动力系统使用需求。</p> <p><b>水冷板</b> 水冷板属于液冷式热交换器件，能够快速带走大功率电子元件运行产生的热量，实现冷却系统结构紧凑化、运行低噪化与使用高可靠化。公司 ECU 水冷板专为新能源汽车动力总成、车身安全及车载信息娱乐系统的车载控制器提供精准温控。产品采用精密冲压成型、全自动激光焊接、铜铝回流焊等工艺，可与 PCB 组件紧密贴集成，保障核心元器件在复杂工况下维持最优工作温度，实现稳定性输出。同时公司具备批量生产牵引驱动电机冷板、动力电池包冷板及 SiC 逆变器水冷板的制造能力。</p> <p><b>EV 电机壳体</b> EV 电机壳体为牵引电机及控制器的外部结构防护壳体，可有效阻隔外界冲击，降低运行振动带来的损耗。产品防护等级达 IP54 及以上，可满足长期工况使用可靠性要求。壳体采用高压真空压铸工艺成型，并结合缸套嵌铸技术保障关键孔位高精度尺寸公差；同时配套全自动摩擦焊接工艺形成高强度密封连接结构，具备优异的抗振动能力与热循环耐受性能。</p> <p>此外，法国 GMD 集团在白车身、底盘结构、热管理系统、内外饰部件方面的技术能力，进一步丰富了公司产品矩阵，提升了面向全球车企提供一体化集成解决方案的综合能力。依托在汽</p>	智能汽车

产品	类型	产品特性介绍	主要应用
		车精密结构件领域长期积累的制造经验与技术沉淀，公司可满足主流整车厂严苛的质量管控要求，为多家全球头部传统及新能源车企的合格供应商。	
	通信设备组件	<p>公司可提供定制化高性能通信零部件产品，适配全球通信网络升级建设需求，核心产品涵盖移动通信天线、移动通信滤波器，能够优化基站室内外部署适配性，提升信号传输稳定性。</p> <p><b>移动通信天线</b> 移动通信天线为基站核心射频器件，主要实现基站与移动终端之间的信号收发传输，适配新一代通信网络建设需求。产品融合低无源互调、高功率承载、宽频覆盖等技术，采用高增益、低传输损耗、低风阻结构设计，实现移相器插入损耗<math>&lt;0.7\text{dB}</math>、天线增益<math>\geq 17.5\text{dBi}</math>、无源互调优于<math>-153\text{dBc}</math>等性能指标，可有效提升移动通信网络运行效率，保障信号高质量收发。</p> <p><b>移动通信滤波器</b> 移动通信滤波器为基站核心选频器件，可筛选指定频段射频信号、滤除杂波干扰，保障通信链路纯净度与设备运行稳定性。产品采用低无源互调设计及高功率金属陶瓷结构，无源互调指标优于<math>-155\text{dBc}</math>，综合工况运行性能稳定。同时产品实现单体体积缩减<math>50\%</math>，有效提升基站内部布局空间利用率与器件集成便捷性。</p> <p>公司通信类零部件围绕高可靠性、宽适配性、高性能进行开发设计，可满足全球主流移动通信网络的技术标准与应用需求。公司主要通信设备组件产品概况如下表所示。</p>	移动基站
	触控面板	触控面板广泛应用于消费类电子（平板，笔记本电脑，一体机）、工控、医疗、车载（中控屏、副驾屏、后排娱乐屏），实现 $\pm 1.0\text{mm}$ 内触摸精度和小于 $30.0\text{ms}$ 的响应时间。具备快速响应时间和对各种复杂环境的适应性，确保了跨行业的通用性。	笔记本电脑、工业控制设备、医疗设备等
光电显示模组	LCD及OLED模组	<p>显示模组（LCD&amp;OLED）可实现“一体化解决方案”，深度融合前沿显示技术与高可靠性结构设计要求，实现性能与稳定性的双重突破。</p> <p>显示模组广泛应用于消费类电子（手机，笔记本电脑，一体机）、工控、医疗、车载（仪表屏，中控屏、副驾屏、后排娱乐屏，电子后视镜，HUD），模组亮度可实现高达<math>1,000.0</math>尼特，确保在强光环境中清晰可见，其中消费类模组可实现超过<math>96.0\%</math> NTSC 宽色域，</p> <p>显示模组采用全贴合层压工艺无缝集成到设备中，从而增强耐用性并提高光学清晰度。凭借自动化制造流程和强大的供应链，我们提供定制化的显示模组，确保高产量、品质如一和可靠交付，有效满足全球不同行业客户的需求。</p>	消费电子、智能汽车等

## （二）经营模式

公司主要产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，并最终实现交付。

### 1、采购模式

公司主要业务包括电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组等多种业务，原材料种类繁多。根据采购规模，公司主要原材料包括电子元器件、连接器、显示器件、覆铜板、压铸件、晶片、铝材等。公司根据订单及生产计划，基于对供应商交货期限及质量的判断向相应的供应商进行采购。公司产品以客户定制化产品为主，供应商需要取得公司或客户的认证，部分物料寻找新的替代供应商需要得到客户的同意和认证，公司一般要求供应商根据订单及时供货，通常不会存留大量多余原材料以及配件，部分情况下也会要求供应商建立本地仓储以缩短原材料交货时间，降低公司的库存。公司采购的原材料具有品类多、采购规模大的特点，公司集团采购管理中心负责统筹协调集团采购行为，倡导绿色采购，充分发挥原材料采购的规模和协同性优势，与核心供应商建立长期稳定、互利共赢的战略合作关系，确保供应链稳定和降低采购成本。

### 2、生产模式

公司产品生产以市场需求为导向，主要实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，经过检验合格后及时配送给客户。公司践行绿色发展、低碳运营的理念，且始终重视推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化融合的主攻方向，积极推进智能工厂和数字化车间建设。一方面，公司大力推动自动化生产建设，提升生产效率，另一方面，公司实施信息化生产运营管理，对生产运营全流程进行实时管控，从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等，确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。

### 3、销售模式

公司销售直接面向企业级客户，在通过客户体系认证、进入客户供应商体系后，由客户直接向公司采购。公司实施集团化销售协同策略，并在各业务板块组建大客户专业服务团队，及时响应客户的需求。公司专注于智能互联互通领域基础核心器件，经过多年的发展，已形成丰富的产品矩阵，相关产品具有较广的行业应用性，且公司不同业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面具备较强的协同性，形成了多产品协同优势，有助于公司为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。

### 4、研发模式

公司建立了以注重核心技术自主研发、满足客户创新需求为导向的高效研发体系，紧跟行业领先客户的战略布局，积极参与客户的新品开发，助力客户的产品迭代和功能创新。同时，公司以打造平台化研发机构、构建平台型核心技术为导向，密切关注行业新技术、新工艺的发展动态，通过持续有效的研发投入和前沿技术研究，确保公司技术及工艺的领先地位，并以此积极推进行业下游终端产品的落地应用和更新迭代。公司重视技术人才培养，通过“育才、引才、留才”等措施为新技术、新产品的开发提供人才保障，并积极协调整合研发资源、鼓励跨部门的联合开发。

公司的研发活动不仅注重自身技术的改造升级，更强调与客户的深度合作和对行业未来趋势的研判。通过灵活性、协作性和创新性的有机结合，构建了一个持续发展、适应能力强的研发生态系统，以应对不断变化的客户需求和市场环境，促进产业链的协同创新。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末 增减	2023 年末
总资产	60,250,537,094.98	46,014,173,064.47	30.94%	44,371,719,028.28
归属于上市公司股东的净资产	21,461,147,972.59	18,826,387,269.38	14.00%	18,143,026,745.54
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	40,124,858,839.52	36,770,374,347.58	9.12%	33,651,205,468.80
归属于上市公司股东的净利润	1,386,066,705.56	1,085,641,847.89	27.67%	1,964,525,269.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,995,066.64	898,627,278.48	7.50%	1,614,534,226.22
经营活动产生的现金流量净额	5,307,141,746.99	4,986,018,688.48	6.44%	5,172,419,470.20
基本每股收益（元/股）	0.79	0.64	23.44%	1.15
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.64	23.44%	1.15
加权平均净资产收益率	6.89%	5.89%	1.00%	11.38%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,602,240,027.91	8,352,923,870.98	10,115,463,490.86	13,054,231,449.77
归属于上市公司股东的净利润	455,862,422.17	302,143,558.44	465,271,630.98	162,789,093.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,749,250.19	260,050,693.12	414,311,224.99	-105,116,101.66
经营活动产生的现金流量净额	1,365,406,591.51	1,134,711,429.77	445,723,379.86	2,361,300,345.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	108,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	

袁永刚	境内自然人	16.53%	302,781,254	252,224,705	质押	104,828,000
袁永峰	境内自然人	13.51%	247,526,917	191,929,879	质押	56,883,800
袁富根	境内自然人	3.21%	58,796,052		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	41,396,650		不适用	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.25%	22,974,707		不适用	
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 深	其他	1.13%	20,660,374		不适用	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.12%	20,451,440		不适用	
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	1.07%	19,570,610		不适用	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 深	其他	0.89%	16,293,622		不适用	
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.82%	15,109,347		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰系袁永刚之兄长，上述父子三人系公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

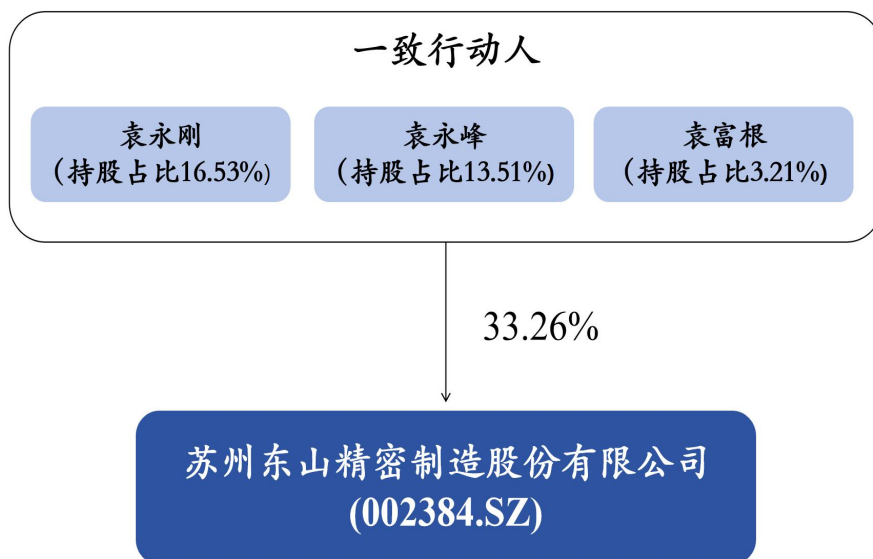
适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

- 公司于 2025 年 6 月 27 日顺利完成 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜。本次发行旨在快速筹措公司发展所需资金，不仅为公司后续战略推进、业务拓展提供了坚实的资金保障，更有效增强了公司控制权的稳定性，助力维护公司良好的市场形象，进一步提升公司整体投资价值与市场认可度。
- 公司第六届董事会第二十一次会议及第六届董事会第二十二次会议，审议通过了收购法国 GMD 集团和索尔思光电事项。通过这两项收购，公司积极推进全球化战略布局，一方面进一步扩大了在汽车零部件领域的市场份额与行业影响力，另一方面成功拓展了光通信领域的业务版图，为持续提升公司综合竞争力、完善产业布局奠定了坚实基础。
- 公司召开第六届董事会第二十七次会议和 2025 年度第三次临时股东会，审议通过了关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市等议案。本次 H 股发行及上市，将有效拓宽公司国际融资渠道，助力公司吸纳国际资本，显著提升公司的国际化品牌影响力与市场形象，更好地满足公司国际化发展需求，为深入推进全球化战略、实现高质量发展注入新动力。